知识点

1.1 半导体基础知识

了解半导体的掺杂性、热敏性与光敏性:半导体掺杂或温度升高或光照,导电能力大 大增强。

概念:本征半导体,P型半导体与 N型半导体,多子与少子,扩散运动与扩散电流,漂移运动与漂移电流。

1.2 PN 结与晶体二极管(重点、难点)

PN 结是所有半导体器件的基础。

晶体二极管是由单 PN 结构成的半导体器件,二极管的本质即 PN 结。二极管具有 PN 结的所有特性。

概念: PN 结(或空间电荷区、势垒区、耗尽层、阻挡层、高阻区), PN 结平衡状态, 势垒电压 U_{op} , 势垒电容 C_{T} , 变容二极管, 理想二极管, 工作点。

- 1. PN 结单向导电性与伏安特性
- (1) PN 结加正向电压时(P区接电源正极N区接电源负极): 内建电场被削弱使势垒降低, 多子扩散电流远大于少子漂移电流, 形成很强的正向导通电流, PN 结导通。
- (2) PN 结加反向电压时(P 区接电源负极 N 区接电源正极): 内建电场被增强使势垒升高,少子漂移电流大于多子扩散电流,形成很小的少子漂移电流(称反向电流)。由于反向电流的值很小且基本不随外加电压变化,一般称作反向饱和电流 I_s 。 I_s 通常忽略不计,故 PN 加反向电压时呈现截止状态。

PN结(晶体二极管)正向导通、反向截止的特性称 PN结的单向导电特性。

(3) 晶体二极管的伏安特性:流过二极管的电流与二极管两端电压之间的关系如下:

$$i = I_s \left(e^{u/U_T} - 1 \right)$$

式中:
$$U_T = \frac{kT}{q} \bigg|_{T=300K} \approx 26 \mathrm{mV}$$
,称为热电压。

当二极管加正向电压时 u>0。当 $e^{u/U_T}>>1$ 时, $i\approx I_s$ e^{u/U_T} ,对应 PN 结正向导通状态。当二极管加反向电压时 u<0,且满足 $e^{u/U_T}<<1$ 时,则 $i\approx -I_s$,可以认为对应 PN 结截止状态。

实际晶体二极管特性表明正向导通时存在门限电压(死区电压) U_r 。对于硅二极管, $U_r=0.5\sim0.7\mathrm{V}$,对于锗二极管, $U_r=0.2\sim0.3\mathrm{V}$ 。

- 2. PN 结击穿特性与稳压管
- (1) PN 结击穿: PN 结外加反向电压且电压值超过一定限度时,反向电流急剧增加而结两端电压基本不变的现象。PN 结击穿时的外加电压称击穿电压 $U_{\rm Z}$ 。

击穿分两类: 雪崩击穿、齐纳击穿。雪崩击穿的击穿电压高于齐纳击穿。

(2) 稳压管:利用 PN 结击穿特性工作的二极管。正常工作时,稳压管上应加反向电压并使其处于反向击穿状态。由于击穿时电流急剧增加,故使用稳压管时应加限流电阻。

稳压管主要参数有: 动态电阻 r_{Z} 、稳定电压 U_{Z} (PN 结击穿电压)、稳定电流 I_{Z} 和额定功耗 P_{Z} 。

3. PN 结温度特性

温度变化时,晶体二极管的反向饱和电流 I_s 、门限电压 U_r 和击穿电压 U_Z 会随之发生变化。

温度每升高 10° C,反向饱和电流 I_s 增大一倍,具有正的温度系数。门限电压的值 $|U_r|$ 随温度升高而减小,具有负的温度系数;雪崩击穿的击穿电压 U_Z 随温度升高而增大,具有正的温度系数;而对于齐纳击穿,击穿电压 U_Z 随温度升高而下降,具有负的温度系数。

4. 晶体二极管重要参数与简化模型

(1) 晶体二极管重要参数: 直流电阻 R_D 和交流电阻 r_d 。

定义:
$$R_D = U/I$$

定义:
$$r_d = du/di$$

分析表明: $r_d = 26 \mathrm{mV}/I_o$ (常温 300K 时),式中 I_o 为二极管工作点的电流。

直流电阻 R_D 与交流电阻 r_d 均为非线性电阻,其值均随工作点Q位置的改变而改变。

(2) 二极管简化模型

①分段线性模型:在工程计算时允许有一定的近似,如图 1 所示。图 (a) 为理想二极管;图 (b) 只考虑门限电压;图 (c) 为既考虑门限电压又考虑交流电阻。需要注意的是:图中认为反向电流为零,且没有工作到击穿区。

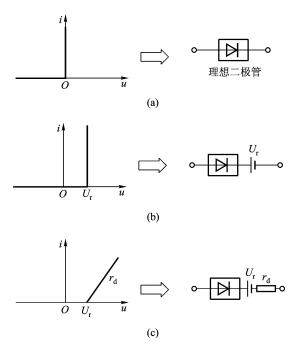


图 1 二极管大信号工作模型图

1.3 晶体三极管(重点、难点)

1. 晶体三极管放大原理

(1) 三极管放大条件:发射结正向偏置,集电结反向偏置。

由放大条件可知,处于放大状态的晶体三极管各极对地的直流电位满足如下关系:对于 NPN 管: $U_C > U_B > U_E$;对于 PNP 管: $U_C < U_B < U_E$ 。

(2) 载流子传输过程。注意分清主体过程与伴随过程。

主体过程:发送(发射区发送的载流子)、传输(基区传送载流子)和收集(集电区收集载流子)载流子。

伴随过程:载流子在基区的复合以及集电结两边的少子漂移。

应当指出:晶体三极管是由两个 PN 结所组成,除了存在载流子扩散运动和漂移运动之外,还存在载流子扩散运动与复合运动一对矛盾,使得晶体三极管具有电流放大作用。

(1) 电流分配关系。

$$\begin{split} I_C &= \overline{\alpha} I_E + I_{CBO} = \overline{\beta} I_B + (1 + \overline{\beta}) I_{CBO} = \overline{\beta} I_B + I_{CEO} \\ I_B &= (1 - \overline{\alpha}) I_E - I_{CBO} \\ I_E &= I_C + I_B = (1 + \overline{\beta}) I_B + I_{CEO} \\ I_{CEO} &= (1 + \overline{\beta}) I_{CBO} \end{split}$$

三极管的基极电流有一微小的变化时,集电极(发射极)电流会相应的发生较大的变化, 三极管是电流控制型器件。

2. 晶体三极管输出特性曲线

输出特性曲线 $i_C = f(i_B, u_{CE})$ 为一簇非线性曲线,分为截止区、放大区、饱和区和击穿区。实际常用的是截止区、放大区和饱和区。如图 2~ 所示。

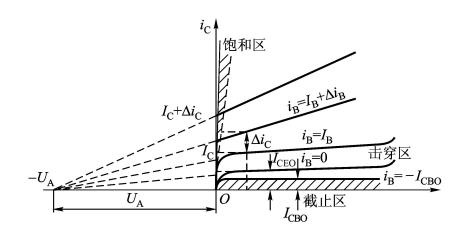


图 2 三极管 (NPN 型) 输出特性

截止区: 对应晶体三极管处于截止状态(发射结、集电结均反向偏置)。特点: $i_E=0$, $i_C=I_{CBO}$, $i_B=-I_{CBO}$ 。

放大区:对应晶体三极管处于放大状态(<mark>发射结正向偏置,集电结反向偏置</mark>),特性曲线平坦部分。特点:具有电流放大作用,存在基调(或厄立)效应。

饱和区:对应晶体三极管处于饱和状态(发射结正向偏置,集电结正向偏置),特性曲线上升部分。特点:固定 u_{CE} , i_C 基本不随 i_B 增加而增加(即:饱和现象);固定 i_B , i_C 随 u_{CE} 剧烈变化。

3. 晶体三极管重要参数与温度特性

(1) 重要参数: 共基极直流电流放大系数 $\overline{\alpha}$ 和交流电流放大系数 α : 共发射极直流

电流放大系数 $\overline{\beta}$ 和交流电流放大系数 β 。其相互关系为:

$$\overline{\beta} = \frac{\overline{\alpha}}{1 - \overline{\alpha}}$$
, $\beta = \frac{\alpha}{1 - \alpha}$

在放大区可以认为 $\beta \approx \overline{\beta}$,不再区分。

(2) 温度特性:

温度升高,晶体三极管的共发射极电流放大系数 β 增大,门限电压 $U_{\mathit{BEO}}(U_{\mathit{EBO}})$ 减小, 反向饱和电流 I_{CRO} 急剧增大,最终导致集电极电流 I_C 的增加。

1.4 场效应管(重点、难点)

1. 场效应管工作原理:

场效应管是利用栅源电压控制漏极电流,进而实现放大功能。它是电压控制器件。

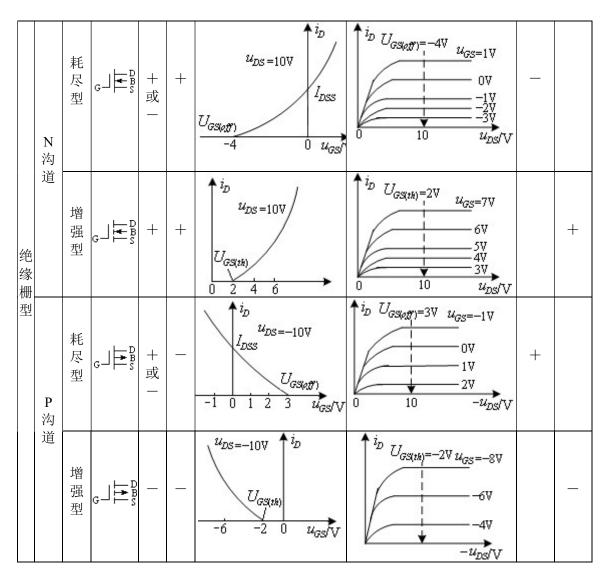
- (1)漏极电流 i_D 受控于栅源电压 u_{GS} : u_{GS} 变化时, i_D 随之单调变化。沟道被夹断时, $i_D = 0$.
- (2)漏极电流 i_D 受漏源电压 u_{DS} 影响: u_{DS} 变化时, i_D 的变化分两阶段。预夹断前, i_D 随 u_{DS} 近似线性变化,称为可变电阻区,又称非饱和区; 预夹断后, u_{DS} 改变 i_D 近似不 变维持恒定,称为饱和区。当 $|u_{GD}|=|U_{GS(off)}|$ ($|U_{GS(th)}|$)时,场效应管处于预夹断状态。

2. 场效应管特性曲线

(1)输出特性曲线:特性曲线中实际用到的区域为截止区、放大区与可变电阻区。 表 1 给出了各种场效应管的特性。

放大状态 的电压 $u_{GS(off)}|u_{GS(th)}|$ 符号 类型 转移特性 输出特性 极性 $u_{GS} | u_{DS}$ $\uparrow^{i_{\!\scriptscriptstyle D}} U_{\!\scriptscriptstyle GS(\!s\!f\!f\!)}^{=-3V} \underline{u_{\!\scriptscriptstyle GS}=0V}$ $h_{\mathcal{D}}$ I_{DSS} $u_{DS} = 10 \text{V}$ N 耗 G→LD 沟 +尽 道 型 $u_{DS/V}$ 型 $\uparrow^{i_{\mathcal{D}}} U_{GS(\rho,\mathcal{Y})}=3V u_{GS}=0V$ $I_{\rm DSS}$ P 耗 $u_{DS=-10V}$ 尽 G * D +沟 +道 型 $U_{GS(
ho ff')}$ 2V $-u_{DS}/V$

表 1 各种类型的 FET 的特性



截止区:对应管子内部沟道未开启即处于夹断的状态。特点:对于 N 沟道场效应管 $u_{GS} \leq U_{GS(off)}$ ($U_{GS(th)}$)时, $i_D=0$;对于 P 沟道场效应管 $u_{GS} \geq U_{GS(off)}$ ($U_{GS(th)}$)时, $i_D=0$ 。

放大区 (恒定电阻区): 对应管子内部沟道发生预夹断后的状态。特点: i_D 受控于 u_{GS} 。 对于 N 沟道场效应管: 当 $u_{GS} > U_{GS(off)}$ ($U_{GS(th)}$),且 $u_{GD} < U_{GS(off)}$ ($U_{GS(th)}$)时,场效应管工作于放大区;对于 P 沟道场效应管: 当 $u_{GS} < U_{GS(off)}$ ($U_{GS(th)}$),且 $u_{GD} < U_{GS(off)}$ ($U_{GS(th)}$),,为效应管工作于放大区。

可变电阻区:对应预夹断前状态。特点:呈线性电阻特性,即: i_D 与 u_{DS} 近似线性关系;不同的 u_{GS} 电阻大小不同,呈变阻特性。

(2) 转移特性曲线:发生预夹断后(即放大区)转移特性曲线基本重合,即认为放大区, u_{DS} 对 i_{D} 无控制作用(输出特性曲线呈现水平)。

3. 场效应管重要参数

(1)交流参数: 跨导 g_m 与背栅跨导 g_{mb} ,输出电阻 r_{ds} 。它们的定义如下:

$$g_{m} = \frac{di_{D}}{du_{GS}}\Big|_{u_{DS}(u_{BS})=C}; \quad g_{mb} = \frac{di_{D}}{du_{BS}}\Big|_{u_{GS}(u_{DS})=C}; \quad r_{ds} = \frac{du_{DS}}{di_{D}}\Big|_{u_{GS}(u_{BS})=C}.$$

 g_m 反映了栅源电压对漏极电流 i_D 的控制能力; g_{mb} 反映了衬底电压 u_{BS} 对漏极电流 i_D 的控制能力; r_{ds} 反映了漏源电压 u_{DS} 对漏极电流 i_D 的控制能力。

(2) 直流参数: 饱和漏极电流 I_{DSS} 、夹断电压 $U_{GS(off)}$ 、开启电压 $U_{GS(th)}$ 。其中: I_{DSS} 、 $U_{GS(off)}$ 为耗尽型场效应管参数; $U_{GS(th)}$ 为增强型场效应管参数。